

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路制造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

中芯截至二零零五年十二月三十一日止三個月業績公佈

- 本公司謹於今日公佈截至二零零五年十二月三十一日止三個月的未經審核經營業績。銷售額由上季的 310,000,000 元升至二零零五年第四季的 333,100,000 元，升幅 7.5%。月產能增至 152,219 片 8 吋等值晶圓。二零零五年第四季的產能使用率為 93%，二零零五年第三季為 92%。二零零五年第四季的毛利率為 12.9%，二零零五年第三季為 8.2%。二零零五年第四季的淨虧損為 15,000,000 元，二零零五年第三季為淨虧損 26,100,000 元。
- 以下為本公司於二零零六年二月六日就截至二零零五年十二月三十一日止三個月的未經審核業績在美國報章所作的報章公佈全文。
- 本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1) 條規定的披露責任而作出本公佈。

所有貨幣數位主要以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

中芯二零零五年第四季業績報告

概要

- 銷售額由上季的 310,000,000 元升至二零零五年第四季的 333,100,000 元，升幅 7.5%。
- 月產能增至 152,219 片 8 吋等值晶圓。
- 二零零五年第四季的產能使用率為 93%，二零零五年第三季為 92%。
- 二零零五年第四季的毛利率由二零零五年第三季 8.2% 增至 12.9%
- 二零零五年第四季的淨虧損由二零零五年第三季的淨虧損 26,100,000 元下降至 15,000,000 元
- 二零零五年第四季的晶圓付運比二零零五年第三季增加 5.8%，至 376,227 片 8 吋等值晶圓。

中國上海—二零零六年二月六日—國際主要半導體承包製造商中芯國際積體電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（「中芯」或「本公司」）於今日公佈截至二零零五年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。二零零五年第四季銷售額由上一季度的310,000,000元上升7.5%至333,100,000元。本公司二零零五年第四季的月產能增至152,219片8吋等值晶圓，二零零五年第四季的使用率為93%。毛利率由二零零五年第三季的8.2%增至二零零五年第四季的12.9%。與二零零五年第三季淨虧損26,100,000元相比，二零零五年第四季的淨虧損減少至15,000,000元。相比於二零零五年第三季，二零零五年第四季晶圓付運數量增加5.8%至376,227片8吋等值晶圓。

“我們繼續收到來自於廣泛客戶群的大量訂單，涵蓋了我們先進和主流工藝技術，”中芯國際總裁兼首席執行官張汝京博士說，“因此，第四季度我們的銷售額和晶圓平均售價都有所增長。

我們繼續通過生產營運獲得大量的資金流通。第四季度我們營運收益現金一億七千四百萬美金，二零零五年全年共六億四千八百萬美金。至本季末，我們現有可支配現金約六億美金，信用貸款超過六億美金，包括最近獲得的由Atradius Dutch State Business N.V. of Amsterdam擔保的貸款一億零五百萬美金，我們會繼續擴充現有產能。我們二零零六年資金支出預算約為十一億美金，這一數位可能會根據市場情況有所調整。另外，我們會通過戰略聯盟尋求其他途徑來進一步擴充產能。

在第四季度中，我們有九位新客戶開始量產，其中兩位是位居世界前列的無廠房公司客戶。我們試生產十九種新產品，其中一半以上來自於中國大陸內地客戶。我們中國大陸的客戶仍然是我們一個重要成長的區域。第四季度中我們開始為九個新客戶代工七種新產品。我們二零零五年十二月有超過百分之八的銷售額來自於中國大陸無廠房公司。這些新產品包括世界第一個使用0.13微米工藝3G基帶的用於TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000格式的晶片，還包括一個用於電視機置頂盒的數位衛星接受器晶片，和一個高清晰數碼電視機視頻處理器晶片。

我們的合資企業專案繼續按計劃進行。具體來說，我們成都的封裝廠於二零零五年十二月開始試生產，之後迅速提升產能。我們預期在二零零六年第一季度就能夠為客戶提供中國大陸包括後端的全方位製造服務。另外，我們和凸版公司的生產芯載濾光片和微鏡的合資企業也於二零零五年十二月試生產，目前正在質量驗證中。”

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零零六年二月七日

時間：上海時間上午八時正

撥號及登入密碼：美國 1-617-614-2714 (密碼：SMIC) 或香港 852-3002-1672 (密碼：SMIC)。

二零零五年第四季業績公佈網上直播可於 www.smics.com 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

有關中芯

中芯國際(NYSE: SMI, SEHK: 0981.HK)，總部位於上海，是一家國際型公司，是世界領先的積體電路晶片代工廠之一，向全世界客戶提供 0.35 微米到 90 納米及更先進工藝的晶片製造服務。公司 2000 年成立以來，其位於上海及天津的四座 8 英寸晶片廠均已量產。另外，其位於北京的中國第一家 12 英寸晶片廠也於 2005 年第一季度開始量產。中芯國際還在美國、歐洲、日本、香港等地設立了辦事處。中芯國際擁有 2500 多名半導體行業的專家及技術骨幹。中芯國際目前已經通過了 ISO9001 認證、ISO/TS16949 認證、OHSAS18001 認證、TL9000 認證、BS7799 認證以及 ISO14001 認證。如需更多資訊，敬請訪問公司網站：<http://www.smics.com>

安全港聲明

(根據 1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈及所附內容可能載有(除歷史資料外)依據1995私人有價證券訴訟改革法案所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述(包括中芯預期產品發展、產品介紹和未來成果的聲明，此聲明有關本集團在現有的工作場所持續擴張產能；二零零六年計劃資本支出約為 1,100,000,000 元；本集團通過戰略聯盟獲得另一種擴張產能的機會以及從二零零六年第一季開始本集團預期在國內提供內部的承包製造業務，正如在二零零六年第一季指引中所述)乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「計劃」、「估計」、「預計」、「預測」及類似表述為該等前瞻性陳述之標識，為并非所有前瞻性陳述均包含上述字眼。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業周期及市場狀況有關的風險、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯量產新產品的能力、半導體承包製造服務供求情況、市場產能過剩、設備、零件及原材料短缺、製造生產量供給及最終市場的金融局勢是否穩定。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的文件資料，包括其於二零零五年六月二十八日以 20-F 表格(經修訂)形式呈交予證交會的登記聲明，特別是「風險因素」

及「有關財政狀況及經營業績的管理層討論及分析」兩個部份、其於二零零四年三月八日以A-1 表格形式呈交予香港聯合交易所（「香港聯交所」）的登記聲明，以及中芯可能不時向證交會及香港聯交所呈交的該等其他文件，包括6-K 表格。其他未知或不可逆料的因素亦可能會對中芯日後的業績、表現或成就造成重大不利影響。鑒於上述風險、不確定性、假設及因素，本新聞發佈中提及的前瞻性事件可能不會發生。務請閣下注意，切勿過份依賴此等前瞻性陳述，此等陳述僅就本新聞發佈中所載述日期（或如無有關日期，則本新聞發佈日期）的情況而表述。

除法律有所規定以外，中芯概不就因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況承擔任何責任，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

投資者聯絡資料：

Jimmy Lai

投資者關係部負責人

電話：86-21-5080-2000，內線 16088

傳真：86-21-5080-3619

Calvin Lau

投資者關係部

電話：86-21-5080-2000，內線 16693

傳真：86-21-5080-3619

手機：+85294352603

手機：+8613636468590

概要：

以千美元為單位（每股盈利和百分比除外）

	二零零五年 第四季度	二零零五年 第三季度	季度比較	二零零四年 第四季度	年度比較
銷售	333,052	309,959	7.5%	291,842	14.1%
銷售成本	290,094	284,686	1.9%	231,293	25.4%
毛利	42,958	25,273	70.0%	60,549	-29.1%
經營開支	51,756	46,219	12.0%	83,937	-38.3%
經營溢利（虧損）	(8,798)	(20,946)	-58.0%	(23,388)	-62.4%
其他收入（支出）	(5,852)	(5,602)	4.5%	12,358	-
所得稅	152	6	2,433.3%	186	-18.3%
收入（虧損）淨額	(14,802)	(26,554)	-44.3%	(11,216)	32.0%
少數股權	(176)	439	-140.1%	-	-
優先股經確認股息	-	-	-	-	-
普通股持有人應占收入（虧損）	(14,978)	(26,115)	-42.6%	(11,216)	33.5%
毛利率	12.9%	8.2%		20.7%	
經營利潤率	-2.6%	-6.8%		-8.0%	
每股基本盈利—每股普通股(1)	(\$0.0008)	(\$0.0014)		(\$0.0006)	
每股基本盈利—每股美國預托股份	(\$0.0410)	(\$0.0718)		(\$0.0311)	
每股攤薄盈利—每股普通股	(\$0.0008)	(\$0.0014)		(\$0.0006)	
每股攤薄盈利—每股美國預托股份	(\$0.0410)	(\$0.0718)		(\$0.0311)	
付運晶圓（8吋等值）(2)	376,227	355,664	5.8%	303,796	23.8%
邏輯平均售價(3)	\$953	\$989	-3.6%	\$1,020	-6.6%
綜合平均售價	\$855	\$841	1.7%	\$917	-6.8%
簡化平均售價(4)	\$885	\$871	1.6%	\$961	-7.9%
產能使用率	93%	92%		95%	

附注：

(1) 基於二零零五年第四季加權平均普通股 18,251,000,000 股，二零零五年第三季 18,180,000,000 股，二零零四年第四季 18,006,000,000 股。

(2) 包括銅接連件

(3) 不包括銅接連件

(4) 銷售總額/晶圓付運總數

• 二零零五年第四季銷售額升至 333,100,000 元，較二零零五年第三季的 310,000,000 元錄得季度升幅 7.5%，並較二零零四年第四季的 291,800,000 元錄得年度升幅 14.1%。導致此等上升的主要因素如下：

- 月產能增至 152,219 片 8 吋等值晶圓
- 8 吋等值晶圓付運升至 376,227 片，較二零零五年第三季的 355,664 片錄得季度升幅 5.8%；
- 綜合平均售價季度增幅為 1.7%
- 產能使用率增至 93%

- 銷售成本從二零零五年第三季的 284,700,000 元增加 1.9%至二零零五年第四季的 290,100,000 元, 主要由於晶圓付運的增加。
- 二零零五年第四季毛利上升至 43,000,000 元, 較二零零五年第三季的 25,300,000 元錄得季度升幅 70.0%; 較二零零四年第四季的 60,500,000 元錄得年度降幅 29.1%
- 毛利率從二零零五年第三季的 8.2%升至二零零五年第四季 12.9%, 主要是綜合平均售價有所提高及存貨跌價準備有所下降。
- 研發費用從二零零五年第三季的 19,200,000 元上升 23.5%至二零零五年第四季 23,700,000 元, 主要是由於製造過程技術研發相關費用。
- 一般行政費用從二零零五年第三季 9,100,000 元下降 11.0%至二零零五年第四季 8,100,000 元, 主要是由於律師費減少。
- 銷售及市場推廣相關費用從二零零五年第三季 4,100,000 元上升 40.0%至二零零五年第四季 5,700,000 元, 主要是因為與銷售行為相關的工程材料費用的增加。
- 無形資產攤銷是指與所獲得無形資產相關的攤銷費用, 此費用從二零零五年第三季 10,700,000 元下降 0.2%至二零零五年第四季 10,600,000 元。
- 經營虧損從二零零五年第三季的 20,900,000 元下降 58.0%至二零零五年第四季 8,800,000 元, 相較於二零零四年第四季的經營虧損 23,400,000 元下降 62.4%。
- 其他非營業性虧損由二零零五年第三季的 5,600,000 元上升 4.5%至二零零五年第四季的 5,900,000 元。
- 二零零五年第四季的利息支出由二零零五年第三季的 10,300,000 元增加 14.1%至 11,800,000 元, 主要是由於借款成本的增加。
- 匯兌淨虧損為 700,000 元, 其中一般行政費用中包括了匯兌虧損 600,000 元, 與融資或投資活動(例如: 遠期合同)相關的非經營性活動產生的匯兌虧損 100,000 元歸類為其他收入(支出)。
- 二零零五年第四季淨虧損由二零零五年第三季淨虧損 26,100,000 元下降 42.6%至 15,000,000 元, 與二零零四年第四季淨虧損 11,200,000 元相比上升 33.5%。

1. 收入分析

	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季	二零零五年 第一季	二零零四年 第四季
以應用分類					
電腦	34.8%	33.7%	39.8%	36.8%	26.8%
通訊	43.8%	39.8%	40.4%	44.5%	58.1%
消費	16.6%	22.8%	15.2%	13.6%	10.2%
其他	4.8%	3.7%	4.6%	5.1%	4.9%
以裝置分類					
邏輯（包括銅接連件）	65.3%	65.5%	58.9%	61.9%	75.1%
DRAM (1)	31.3%	31.0%	36.5%	33.0%	20.4%
其他（光罩製造及探測等）	3.4%	3.5%	4.6%	5.1%	4.5%
以客戶類別分類					
非廠房半導體公司	43.2%	43.2%	42.2%	48.1%	50.2%
集成裝置製造商	51.7%	52.8%	55.2%	49.6%	47.5%
系統公司及其它	5.1%	4.0%	2.6%	2.3%	2.3%
以地區分類					
北美洲	39.2%	42.9%	40.8%	40.4%	34.9%
亞太區（不包括日本）	28.2%	25.7%	26.3%	26.9%	43.5%
日本	3.6%	4.5%	6.0%	8.0%	8.8%
歐洲	29.0%	26.9%	26.9%	24.7%	12.8%
晶圓收入分析					
各技術占晶圓銷售額的百分比 （僅包括邏輯、記憶及銅連接件）					
0.13 微米	42.9%	43.8%	44.5%	29.2%	13.8%
0.15 微米	5.2%	2.7%	2.5%	12.5%	14.9%
0.18 微米	42.3%	45.3%	40.7%	40.3%	33.6%
0.25 微米	3.3%	3.1%	3.9%	4.6%	6.0%
0.35 微米	6.3%	5.1%	8.4%	13.4%	31.7%
各邏輯技術占邏輯晶圓銷售額百分比 (1)					
0.13 微米 (2)	10.9%	14.7%	12.6%	5.4%	2.4%
0.15 微米	8.6%	5.3%	4.8%	2.2%	5.3%
0.18 微米	65.3%	67.4%	59.4%	59.8%	38.2%
0.25 微米	4.8%	4.0%	7.1%	7.1%	7.8%
0.35 微米	10.4%	8.6%	16.1%	25.5%	46.3%

附注：

- (1) 不包括 0.13 微米銅接連件
- (2) 代表來自于全流程製造晶圓的銷售收入

- 與二零零五年第三季相比，二零零五年第四季應用於通訊類產品的晶片的銷售增長速度快於其他應用領域。

- 二零零五年第四季源自亞太（例如：日本）及歐洲客戶的銷售占總銷售額的百分比與二零零五年第三季度的 25.7%及 26.9% 相比，上升至 28.2%及 29.0%。
- 二零零五年第四季 0.18 微米及以下技術晶圓的銷售占晶圓銷售額百分比與二零零五年第三季度的 91.8%相比下降至 90.4%，而與二零零四年第四季度的 62.3%相比有所上升。
- 二零零五年第四季 0.18 微米及以下技術邏輯晶圓的銷售額占邏輯晶圓銷售額的百分比與二零零五年第三季度的 87.4%相比下降至 84.8%，而二零零四年第四季度為 45.9%。
- **產能：**

<u>廠／（晶圓尺寸）</u>	<u>二零零五年第四季⁽¹⁾</u>	<u>二零零五年第三季⁽¹⁾</u>
一廠（8 吋）	43,441	43,000
二廠（8 吋）	46,451	44,378
四廠（12 吋）	27,368	21,605
七廠（8 吋）	15,000	15,000
每月晶圓裝配總產能	132,260	123,983
銅接連件：		
三廠（8 吋）	19,959	19,205
每月銅接連件總產能	19,959	19,205

附注：

（1）期終每月晶圓計，8 吋等值

- 截至二零零五年第四季度末，每月產能增加至 152,219 件 8 吋等值晶圓。

付運及使用率：

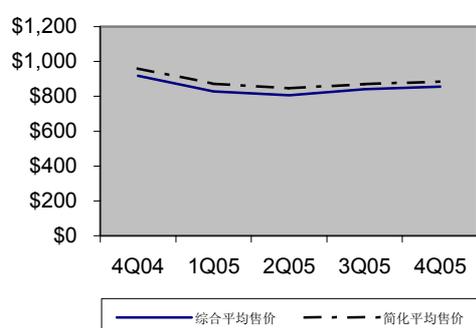
<u>8 吋晶圓</u>	<u>二零零五年第四季</u>	<u>二零零五年第三季</u>	<u>二零零五年第二季</u>	<u>二零零五年第一季</u>	<u>二零零四年第四季</u>
付運晶圓（包括銅接連件）	376,227	355,664	330,499	284,912	303,796
使用率 ⁽¹⁾	93%	92%	87%	85%	95%

附注：

（1）使用率按輸出品圓總額除以估計產能計算

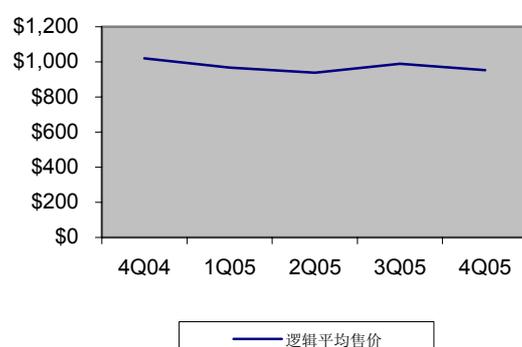
- 二零零五年第四季晶圓付運增加至 376,227 片 8 吋等值晶圓，分別較二零零五年第三季的 355,664 片及二零零四年第四季度的 303,796 片分別錄得季度升幅 5.8%及年度升幅 23.8%。
- 二零零五年第四季使用率上升至 93%。

綜合平均售價和簡化平均售價趨勢



綜合平均售價和簡化平均售價從二零零五年第三季的 841 元和 871 元上升至二零零五年第四季的 855 元和 885 元，主要由於整個 DRAM 代工業價格環境的調漲

邏輯平均售價趨勢 (不包括 0.13 微米銅件連接)



二零零五年第四季邏輯平均售價(不包括 0.13 微米銅接連件)由二零零五年第三季的 989 元下降至 953 元，主要由於產品組合的改變。

2. 詳細財務分析

毛利分析

以千美元計	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季	季度比較	二零零四年 第四季	年度比較
銷售成本	290,094	284,686	1.9%	231,293	25.4%
折舊	176,545	167,919	5.1%	130,839	34.9%
其他製造成本	113,549	116,767	-2.8%	100,454	13.0%
毛利	42,958	25,273	70.0%	60,549	-29.1%
毛利率	12.9%	8.2%		20.7%	

- 銷售成本從二零零五年第三季的 284,700,000 元增加 1.9%至二零零五年第四季的 290,100,000 元，主要由於晶圓付運的增加。
- 二零零五年第四季毛利為 43,000,000 元，與二零零五年第三季的 25,300,000 元相比錄得季度升幅 70.0%，與二零零四年第四季的 60,500,000 元相比錄得年度降幅 29.1%。
- 毛利率從二零零五年第三季的 8.2%上升至二零零五年第四季 12.9%，主要是主要是綜合平均售價有所提高及存貨跌價準備有所下降。

經營開支分析

以千美元計	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季	季度比較	二零零四年 第四季	年度比較
總經營開支	51,756	46,219	12.0%	83,937	-38.3%
研究及開發	23,747	19,230	23.5%	24,747	-4.0%
一般及行政	8,122	9,122	-11.0%	25,476	-68.1%
銷售及市場推廣	5,699	4,072	40.0%	2,544	124.1%
訴訟解決	-	-	-	23,153	-
取得無形資產攤銷	10,640	10,660	-0.2%	4,092	160.0%
遞延股份報酬攤銷	3,548	3,135	13.2%	3,925	-9.6%

- 總經營開支從二零零五年第三季的 46,200,000 元升至 51,800,000 元，錄得季度升幅 12.0%。
- 研發費用從二零零五年第三季的 19,200,000 元上升 23.5%至二零零五年第四季 23,700,000 元，主要是由於製造過程技術研發相關費用。
- 一般行政費用(包括匯兌損益)從二零零五年第三季 9,100,000 元下降 11.0%至二零零五年第四季 8,100,000 元，主要由於律師費的減少。
- 銷售及市場推廣相關費用從二零零五年第三季 4,100,000 元上升 40.0%至二零零五年第四季 5,700,000 元，差額主要因為與銷售行為相關的工程材料費用增加。
- 取得無形資產攤銷是指與所獲得無形資產相關的攤銷費用，此費用從二零零五年第三季 10,700,000 元下降 0.2%至二零零五年第四季 10,600,000 元。

非經營收入(支出)

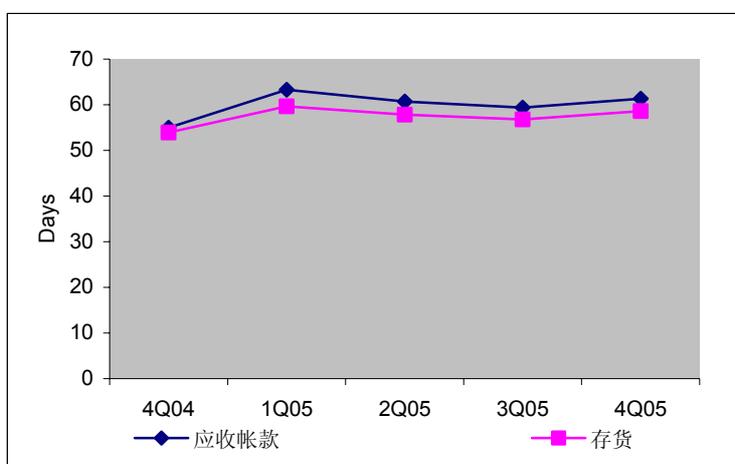
以千美元計	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季	季度比較	二零零四年 第四季	年度比較
其他收入(支出)	(5,852)	(5,602)	4.5%	12,358	-
利息收入	4,120	3,278	25.7%	3,264	26.2%
利息支出	(11,792)	(10,334)	14.1%	(4,581)	157.4%
其他，淨額	1,820	1,454	25.2%	13,675	-86.7%

- 二零零五年第四季其他非營業性虧損為 5,900,000 元，相較於二零零五年第三季度虧損 5,600,000 元上升了 4.5%。
- 二零零五年第四季的利息支出由二零零五第三季的 10,300,000 元增加 14.1%至 11,800,000 元，主要是由於借款成本的增加。
-

3. 流動資金

以千美元計	二零零五年第四季	二零零五年第三季
現金及現金等價物	585,797	576,767
短期投資	13,796	5,582
應收賬款	241,334	212,823
存貨	191,238	182,851
其他	15,300	12,582
總流動資產	1,047,465	990,605
應付賬款	262,318	259,797
短期借款	265,481	266,589
長期借款的即期部份	246,081	246,081
其他	122,158	113,154
總流動負債	896,038	885,621
現金比率	0.7x	0.7x
速動比率	1.0x	0.9x
流動比率	1.2x	1.1x

應收賬款／存貨的各日走勢



資本結構

以千美元計	二零零五年第四季	二零零五年第三季
-------	----------	----------

現金及現金等價物	585,797	576,767
短期投資	13,796	5,582
長期票據即期部分	29,242	19,578
長期票據	103,254	116,749
短期借款	265,481	266,589
長期借款的即期部份	246,081	246,081
長期借款	494,556	444,566
總借款	1,006,118	957,236
現金淨額	(539,021)	(511,214)
股東權益	3,026,099	3,034,237
總借款對權益比率	33.2%	31.5%

4. 現金流量及資本開支

以千美元計	二零零五年第四季	二零零五年第三季
虧損淨額	(14,978)	(26,115)
折舊及攤銷	201,358	192,347
購入無形資產攤銷	10,640	10,661
現金變動淨額	9,030	474

資本開支

- 二零零五年第四季資本開支為 229,800,000 元。
- 計劃下的二零零六年資本開支將約為 1,100,000,000 元，並將根據市場情況作相應調整。

5. 二零零六年第一季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已于之前的安全港聲明中闡明。

- 晶圓付運預期將增長 2%-4%。
- 使用率預期約為 92%至 94%。
- 綜合平均銷售價格季度預計將持平。
- 毛利率預計將維持二零零五年第四季度的水平。
- 經營開支相對銷售的百分比預計將介於 16%至 18%之間。

- 非經營利息支出預期約至 14,000,000 元左右，主要由於對既存信用額度的追加提取所至。
- 資本開支約介於 250,000,000 元至 300,000,000 元之間。
- 折舊及攤銷約為 225,000,000 元。
- 根據美國財務會計準則第 123 號修訂版，遞延股票報酬約為 7,200,000 元左右，其中 4,200,000 元列入經營開支，3,000,000 元列入銷售成本。

6. 近期公佈

- 中芯國際為杭州國芯製造生產之晶片贏得“重大技術發明獎”。(二零零六年一月十八日)
- 中芯國際與 ARC 聯合將可調式微處理器引入中國。(二零零六年一月九日)
- 中芯國際採用明導科技 Eldo 模擬器於 0.13 微米及以下工藝的類比電路設計中。(二零零六年一月六日)
- 英飛凌與中芯國際將合作協定擴展至 90 奈米生產領域。(二零零六年一月六日)
- 中芯國際與 SAIFUN 拓展 NROM 技術轉讓協定。(二零零六年一月四日)
- 中芯國際推出低壓降 (LDO) 線性穩壓器智慧模組系列。(二零零五年十二月二十一日)
- 中芯國際獲得八千五百萬歐元荷蘭長期出口信貸貸款。(二零零五年十二月十四日)
- 推 CMOS 圖像感測器市場，中芯國際 0.18 微米彩色-VGA. 感測器進入批量生產。(二零零五年十二月七日)
- 中芯國際發佈 0.18 微米電可擦除唯讀記憶體 (EEPROM) 工藝技術及智慧模組設計平臺。(二零零五年十二月二日)
- 更改主要營業地點。(二零零五年十二月一日)
- 中芯國際和 Magma 公司聯合發佈 0.13 微米參考流程。(二零零五年十一月十五日)
- 推動 1080P 高清晰度背投電視市場，中芯國際 LCOS 背板晶片進入批量生產。(二零零五年十一月十一日)
- 中芯國際公佈二零零五年第三季經營業績。(二零零五年十月二十八日)

- 芯原和中芯國際共同宣佈 0.13 微米半導體標準設計平臺正式發佈。(二零零五年十月二十八日)
- 中芯國際 2005 年技術研討會在深圳召開。(二零零五年十月十三日)
- 中芯國際與重慶重郵信科成功製造 0.13 微米 3G 手機專用晶片。(二零零五年十月十二日)
- 中芯國際與朗明科技簽訂協定聯合開發 65 納米及以下制程技術。(二零零五年十月六日)
-

上述公佈詳情請參閱中芯網站。

http://www.smics.com/website/enVersion/Press_Center/pressRelease.jsp

中芯財務資料

合并資產負債表
(美元)

截至以下日期止三個月

	二零零五年十二月三十一日 (未經審核)	二零零五年九月三十日 (未經審核)
資產		
流動資產：		
現金及現金等價物	585,796,887	576,766,591
短期投資	13,795,859	5,581,511
應收賬款，已扣除撥備（二零零五年十二月三十一日為 1,091,340 元，二零零五年九月三十日為 284,091 元）	241,333,914	212,822,764
存貨	191,237,636	182,850,604
預付款項及其它流動資產	15,300,591	12,583,729
流動資產合計	1,047,464,887	990,605,199
土地使用權，淨額	34,767,518	38,136,980
廠房及設備，淨額	3,285,631,131	3,284,892,971
購入無形資產，淨額	195,178,898	202,843,555
長期投資	17,820,890	18,340,174
其他非流動資產	2,552,407	-
資產合計	4,583,415,731	4,534,818,879
負債及股東權益		
流動負債：		
應付帳款	262,318,432	259,796,976
預提費用及其它流動負債	92,916,030	93,576,700
短期借款	265,481,082	266,589,185
長期票據的即期部份	29,242,001	19,577,936
長期借款的即期部份	246,080,580	246,080,580
流動負債合計	896,038,125	885,621,377
長期負債：		
長期票據	103,254,436	116,748,925
長期借款	494,556,385	444,566,420
其他長期應付款	24,686,398	15,039,304
長期負債合計	622,497,219	576,354,649
負債合計	1,518,535,344	1,461,976,026
承諾		
少數股權	38,781,863	38,605,893

股東權益：

普通股，面值 0.0004 元，法定股份為 50,000,000,000 股，截止二零零五年十二月三十一日已發行股份為 18,301,680,867 股，未發行的股份為 18,282,217,408 股。

認股權證	7,320,674	7,312,888
額外繳入股本	32,387	32,387
應收股東票據	3,291,407,447	3,290,310,978
累計其他綜合盈餘	–	(247,137)
遞延股票報酬	138,978	794,214
累計虧絀	(24,881,919)	(31,025,668)
	(247,919,043)	(232,940,702)
所有股東權益合計	3,026,098,524	3,034,236,960
總負債及股東權益合計	4,583,415,731	4,534,818,879

合并營運報表
(美元)

	截至以下日期止三個月	
	二零零五年十二月三十一日 (未經審核)	二零零五年九月三十日 (未經審核)
銷售額	333,051,413	309,959,083
銷售成本	287,156,674	281,908,983
銷售成本－遞延股票報酬攤銷	2,937,243	2,777,550
毛利	42,957,496	25,272,550
經營費用：		
研究和開發	23,746,620	19,229,715
一般管理	8,121,786	9,121,980
銷售和市場推廣	5,699,526	4,071,957
購入無形資產攤銷	10,639,905	10,660,670
遞延股票報酬攤銷*	3,548,051	3,134,817
經營費用總額	51,755,888	46,219,139
經營虧損	(8,798,392)	(20,946,589)
其他收入(支出)：		
利息收入	4,119,974	3,277,964
利息支出	(11,791,740)	(10,333,503)
其他淨額	2,214,436	1,453,794
其他淨收入(支出)總額	(5,457,330)	(5,601,745)
應占聯營公司虧損	(395,013)	-
稅前虧損淨額	(14,650,735)	(26,548,334)
所得稅	151,636	6,068
少數股權	(175,970)	438,934
淨虧損	(14,978,341)	(26,115,468)
視為已派付優先股股息	-	-
普通股持有人應占虧損淨額	(14,978,341)	(26,115,468)
每股份收入淨額，基本	(0.0008)	(0.0014)
每股美國預托股份收入淨額，基本(1)	(0.0410)	(0.0718)
每股份收入淨額，攤薄	(0.0008)	(0.0014)

每股美國預托股份收入 淨額，攤薄(1)	(0.0410)	(0.0718)
用作計算基本每股收入 淨額的股份（以百萬計）	18,251	18,180
用作計算攤薄每股收入 淨額的股份（以百萬計）	18,251	18,180
* 遞延股票報酬攤銷乃關於：		
研究和開發	1,217,349	1,125,943
一般和管理	1,681,284	1,403,732
銷售及市場推廣	649,418	605,142
總計	3,548,051	3,134,817

(1) 一股美國預托股份等於 50 股普通股。

合并现金流量表
(美元)

	截至以下日期止三個月	
	二零零五年十二月三十一日 (未經審核)	二零零五年九月三十日 (未經審核)
經營活動：		
普通股持有人應占虧損	(14,978,341)	(26,115,468)
視為已派付優先股股息	-	-
淨虧損	(14,978,341)	(26,115,468)
淨虧損至經營活動所得(所耗)現金淨額對賬的調整：		
少數股權	175,970	(438,934)
出售廠房及設備的收益(虧損)	(1,776,513)	(1,245,543)
(沖銷)呆賬撥備	807,249	174,729
折舊及攤銷	201,358,428	192,347,054
購入無形資產攤銷	10,639,905	10,660,671
遞延股票報酬攤銷	6,485,294	5,912,367
非現金長期票據利息費用	2,037,607	1,033,022
長期投資虧損	519,284	784,556
營運資產及負債的變動：		
應收賬款	(29,318,399)	(16,865,479)
存貨	(8,387,032)	(6,348,289)
預付款及其它流動資產	(5,937,696)	2,864,683
應付賬款	(5,242,931)	24,244,703
預提費用及其它流動負債	17,817,242	12,330,949
經營活動所得現金淨額	174,200,067	199,339,021
投資活動：		
購入廠房及設備	(208,688,953)	(188,180,850)
購買所獲無形資產	(3,749,999)	(2,663,628)
購入短期投資	(12,183,063)	(5,217,982)
長期投資已付款項	-	(9,600,000)
出售短期投資	3,983,468	2,412,898
出售生活園區所得款項	7,948,629	4,614,394
處置固定資產所得款項	2,630,000	-
投資活動所耗現金淨額	(210,059,918)	(198,635,168)
融資活動：		
短期借款所得款項	64,320,752	91,918,751
長期借款所得款項	49,909,022	74,985,000
償還長期借款支付的款項	-	(124,769,718)
償還長期票據支付的款項	(5,000,000)	-
償還短期借款支付的款項	(65,347,912)	(49,330,000)
行使雇員購股權所得款項	762,710	561,806
收取雇員應收認購款項	247,137	40,492

政府撥款所得款項	-	6,456,486
融資活動所得現金淨額	44,891,709	(137,183)
匯率變動的影響	(1,562)	(92,258)
現金及現金等價物增加(減少)淨額	9,030,296	474,412
現金及現金等價物—二零零五年十月一日	576,766,591	576,292,179
現金及現金等價物—二零零五年十二月三十一日	585,796,887	576,766,591

於本公佈刊發日期，本公司董事分別有董事會主席及獨立非執行董事王陽元、執行董事張汝京、非執行董事姚方、獨立非執行董事徐大麟、周延鵬、川西剛、蕭崇河及陳立武。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
首席執行官
張汝京

中國 上海，二零零六年二月六日

* 僅供識別